

# BRAZETEC Aktivlote und Aktivlotpasten



## / BRAZETEC Aktivlote

Für BRAZETEC Aktivlote ist eine minimale Löttemperatur von 850 °C notwendig, um eine Verbindung mit der Keramik zu erreichen. Höhere Löttemperaturen können das Benetzungsverhalten verbessern. Als Lötatmosphären werden reines Argon (4.8) oder Vakuum (<math>10^{-3}</math> mbar) empfohlen.

Im Fall einer Vakuumlötung mit CB 4 sollte die Löttemperatur nicht wesentlich über 900 °C bzw. bei Verwendung von CB 2 und CB 6 nicht wesentlich über 1000 °C liegen, um ein Abdampfen von Silber zu vermeiden.

Bezeichnung	Zusammensetzung in Gewicht-%				Schmelzbereich nach DSC	Schmelzbereich nach ISO 17672	Optimale Löttemp.	Dichte	Besonderheiten der Anwendung	Lieferform
	Ag	Cu	In	Ti	in °C	in °C	in °C	in g/cm <sup>3</sup>		
BrazeTec CB 2	96	-	-	4	970	-	1.000	10,3	Keramik, Keramik/Metall-Verbindungen, Grafit, Diamant, Saphir, Rubin	   
BrazeTec CB 4	70,5	26,5	-	3	780 – 820	-	850	9,9	Keramik, Keramik/Metall-Verbindungen, Grafit, Diamant, Saphir, Rubin	   
BrazeTec CB 6	98,4	-	1	0,6	950 – 960	-	1.000	10,3	Siliziumnitrid	   

## / BRAZETEC Aktivlotpasten

Die BRAZETEC Aktivlotpasten haben einen hohen Metallgehalt, der auf die Anwendung des Produktes optimiert ist.

Auf Anfrage sind Legierungen mit abweichendem Titan-Gehalt lieferbar.

Bezeichnung	Zusammensetzung in Gewicht-%				Schmelzbereich	Optimale Löttemperatur	Besonderheiten der Anwendung	Lieferform
	Ag	Cu	In	Ti	in °C	in °C		
BrazeTec CB 10	64,8	25,2	-	10	780 – 805	850	Keramik, Keramik / Metall-Verbindungen, Grafit, Diamant, Saphir, Rubin	 
BrazeTec CB 11	90	-	-	10	970	1.000	Keramik, Keramik / Metall-Verbindungen, Grafit, Diamant, Saphir, Rubin	 
BrazeTec CB 12	55,1	39,9	-	5	780 – 855	>900	Keramik/Metall-Verbindungen, PKD-, CBN Anwendung	 
BrazeTec CB 17	59,1	27,2	12,5	1,2	605 – 720	780 – 800	Keramik/Metall-Verbindungen, PKD-, CBN Anwendung	 

 Draht
  Stäbe
  Band
  Formteile
  Dosen
  Kartuschen